

※課題番号 : F-12-KT-0123
※支援課題名 (日本語) : ドライエッチングによる立体加工
※Program Title (in English) : 3D Processing by Dry Etching
※利用者名 (日本語) : 岡野 渚
※Username (in English) : Nagisa Okano
※所属名 (日本語) : スターライト工業株式会社 営業本部 商品企画室
※Affiliation (in English) : Starlite Co., Ltd.

※概要 (Summary) :

【相談内容】

京都大学ナノテクノロジーハブ拠点所有の各種ドライエッチング装置を使用した格子パターン (扇型, 三角形など) の実現可能性を確認したい. 特に, エッチング面接点でのパターン精度について.

また, これまで, 某ドライエッチング装置を使用しているが, 当拠点の各種ドライエッチング装置の利点を確認したい.

○希望利用装置 :

- ・深掘りドライエッチング装置 (B08)
 - ・磁気中性線放電ドライエッチング装置 (B09)
 - ・ドライエッチング装置 (B10)
 - ・電子サイクロトロン共鳴イオンビーム加工装置 (B11)
- など

【回答】

深掘りドライエッチング装置 (B08) において, エッチング条件の最適化により所望形状のエッチングは可能であると推測される. しかし, 利用者での現在使用中のドライエッチング装置と比べ, 当拠点の装置は同等レベルのものであり, 利点は少ないと思われる.

【結果】

H25 年度から自主事業としてナノハブの利用に進む見込み.

※実験 (Experimental) :

技術相談のため割愛.

※結果と考察 (Results and Discussion) :

技術相談のため割愛.

※その他・特記事項 (Others) :

特になし.